

ATTUALITÀ

Il Chips Act della commissione europea e l'iniziativa italiana nel settore dei semiconduttori

16 Marzo 2022

Edoardo Gambaro, Partner, Greenberg Traurig Santa Maria

Martino Basilisco, Trainee, Greenberg Traurig Santa Maria



Edoardo Gambaro, Partner,
Greenberg Traurig Santa Maria

Martino Basilisco, Trainee,
Greenberg Traurig Santa Maria

> Edoardo Gambaro

Edoardo Gambaro si occupa principalmente di diritto della concorrenza italiano ed europeo. Ha assistito società italiane e straniere davanti alla Commissione europea, all'AGCM e alle giurisdizioni europee in procedimenti riguardanti cartelli, abusi di posizione dominante, aiuti di Stato e in materia antitrust. L'Avv. Gambaro ha, altresì, acquisito una considerevole esperienza nell'ambito del controllo delle concentrazioni, assistendo imprese europee e statunitensi nella notifica di operazioni straordinarie. Si occupa anche di altri aspetti del diritto dell'UE, come la normativa sulle telecomunicazioni, il diritto farmaceutico e le libertà di stabilimento e di circolazione di beni e servizi. È professore invitato di diritto del processo UE all'Università di Milano Bicocca.

La Commissione presenta un piano per quadruplicare la produzione europea di chip entro il 2030. L'Italia tenta di ritagliarsi uno spazio da protagonista con uno stanziamento di quasi 4 miliardi di euro fino al 2030.

I *chip* rappresentano una componente essenziale per tutte le industrie altamente tecnologiche, dagli *smartphone* all'*automotive*, alla sanità, all'aerospaziale e alle nuove innovazioni digitali, come il *cloud*, il 5G e i computer quantistici. Tuttavia, la loro produzione risulta fortemente concentrata nelle mani di un esiguo numero di operatori asiatici, per lo più taiwanesi e coreani. Negli ultimi due anni, la pandemia e le tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti hanno causato considerevoli rallentamenti alla filiera globale dei semiconduttori, di fronte ai quali l'industria europea si è trovata impreparata.

1. Il nuovo Chips Act della Commissione europea: il rilancio dell'UE nell'industria dei semiconduttori

Per far fronte alla crescente carenza di *chip*, l'8 febbraio 2022 la Commissione europea ("**Commissione**") ha proposto un'ampia serie di misure per rafforzare la produzione UE di *chip* semiconduttori. L'obiettivo è incrementare la capacità produttiva dei Paesi dell'UE fino a raggiungere un quinto dell'offerta globale entro il 2030, di fatto quadruplicando la produzione attuale.

La proposta della Commissione si compone di un regolamento, il cosiddetto "**Chips Act**"¹ - il quale, una volta discusso e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, diventerà direttamente applicabile in tutti i 27 Stati membri dell'UE - di una raccomandazione, volta ad attuare alcune misure prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento ("**Raccomandazione**")² e di una comunicazione, che illustra il contesto e le finalità dell'intervento ("**Comunicazione**")³.

¹ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem (Chips Act), 8 febbraio 2022, COM(2022) 46 final 2022/0032 (COD).

² Raccomandazione della Commissione del 8.2.2022 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per affrontare la carenza di semiconduttori e a un meccanismo dell'UE per il monitoraggio dell'ecosistema dei semiconduttori, C(2022) 782 final.

³ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *A Chips Act for Europe*, 8.2.2022 COM(2022) 45 final

La prima misura, prevista nel breve termine, consiste nella creazione di un sistema di monitoraggio della catena del valore globale dei semiconduttori, al fine di anticiparne future perturbazioni. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a raccogliere e condividere informazioni sui relativi mercati nazionali con un gruppo di esperti istituito dalla Commissione. È previsto, inoltre, un insieme di misure di intervento rapido in caso di crisi, quali richieste obbligatorie di informazioni alle imprese, programmi di acquisto comuni e, eventualmente, anche limitazioni alle esportazioni di componenti essenziali.

In aggiunta, nel medio-lungo periodo, l'iniziativa della Commissione prevede:

- (i) un aumento sostanziale dei finanziamenti alla ricerca - attraverso la nuova *Chips Joint Undertaking* del programma Horizon Europe - specialmente in relazione ai *transistor* avanzati e di processori a basso consumo energetico, con 1 miliardo di euro dedicato esclusivamente allo sviluppo di *chip* quantistici;
- (ii) la creazione, attraverso l'iniziativa *Chips for Europe*, di un'infrastruttura di progettazione su larga scala per le tecnologie integrate dei semiconduttori, tra cui una piattaforma virtuale per la condivisione di nuovi modelli e progetti, accessibile anche alle PMI e alle organizzazioni di ricerca, nonché la creazione di linee pilota per testare nuovi prototipi;
- (iii) investimenti nell'istruzione, incoraggiando l'accesso alla formazione post-laurea e l'utilizzo di tecnologie innovative, grazie alla creazione di centri di competenza europei.

Per quanto riguarda il rafforzamento della capacità produttiva dell'UE, la Commissione ha evidenziato la necessità di un maggiore finanziamento pubblico per lo sviluppo di nuovi impianti. L'UE prevede quindi di mobilitare circa 11 miliardi di euro di risorse proprie entro il 2030. A ciò si aggiungerebbero i contributi degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti e del settore privato, per un investimento totale pari a circa 43 miliardi di euro.

Di questi, oltre 2 miliardi di euro sarebbero destinati esclusivamente al finanziamento di *start-up* e PMI innovative attive nel settore dei semiconduttori, attraverso il programma InvestEU.

I finanziamenti pubblici qualificabili come "aiuti di Stato", ove non rientranti nelle esenzioni già previste

dalle linee guida vigenti, dovranno comunque essere notificati dagli Stati membri all'Esecutivo UE per essere sottoposti a una valutazione caso per caso, per stabilire se l'aiuto ha un effetto incentivante ed è necessario, appropriato e proporzionato.

A tal fine, la Commissione specifica che i finanziamenti agli impianti di produzione di semiconduttori saranno analizzati nell'ambito dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("**TFUE**"), in quanto aiuti destinati a promuovere specifiche attività economiche. Per ottenere il via libera, gli aiuti dovranno generare effetti positivi superiori al potenziale impatto negativo sugli scambi e la concorrenza.

Il *Chips Act* indica i seguenti criteri di cui la Commissione terrà conto nell'ambito della propria valutazione:

- (i) gli impianti destinatari dell'aiuto dovranno essere "primi nel loro genere" nell'UE, contribuendo all'avanzamento tecnologico del settore;
- (ii) le fabbriche dovranno generare un impatto positivo sulla catena del valore dei semiconduttori dell'UE in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e aumento della forza lavoro qualificata;
- (iii) gli impianti dovranno essere destinati alla produzione della prossima generazione di *chip* e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico dovrà essere limitato entro i confini europei.

Gli impianti che rispondono a tali criteri potranno essere qualificati alternativamente come "*fonderie aperte UE*", quando dedicano la maggior parte della propria capacità produttiva ad altri attori industriali, o come "*impianti di produzione integrati*", se producono componenti per uso interno. L'ottenimento di una di queste qualifiche darà accesso a procedure autorizzative più rapide alle precitate linee pilota e gli investimenti in tali impianti saranno automaticamente qualificati come di interesse pubblico.

Queste regole, contenute nella bozza del *Chips Act*, saranno applicate dalla Commissione anche agli aiuti notificati prima dell'entrata in vigore del regolamento.

2. L'iniziativa UE nel contesto globale dei semiconduttori: tra scenari geopolitici e sviluppo economico

Le misure proposte dalla Commissione rappresentano un importante tassello nella costruzione di una politica industriale coordinata a livello UE. E invero, il *Chips Act* è da accogliere positivamente, nella misura in cui, sebbene non introduca eccezioni *ad hoc* per il finanziamento al settore dei *chip*, offre comunque maggiore certezza sulla valutazione da parte della Commissione di eventuali aiuti di Stato al settore. Del resto, il co-finanziamento pubblico risulta necessario per creare nuovi impianti, dato che la produzione di *chip* va sempre più verso il modello della *giga-factory*, i cui costi di installazione ammontano a diversi miliardi di euro per ogni singolo impianto.

All'iniziativa della Commissione si affiancano le misure già adottate dai singoli Stati membri, tra cui l'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica ("**IPCEI**"), che riunisce Italia, Francia, Germania, Austria Regno Unito. L'IPCEI prevede finanziamenti pari a circa due miliardi di euro per progetti transnazionali di sviluppo di nuovi prodotti di microelettronica in cinque settori chiave: *chip* ad alta efficienza energetica, semiconduttori di potenza, sensori intelligenti, apparecchiature ottiche avanzate e materiali composti. I fondi messi a disposizione dall'Italia nell'ambito di questa iniziativa, attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, ammontano a circa 700 milioni di euro.

L'UE non è stata la sola a promettere ingenti investimenti. Le maggiori economie globali, tra cui USA, Cina, Giappone e Corea, hanno stanziato somme addirittura superiori rispetto a quelle indicate dalla Commissione. Basti pensare che gli Stati Uniti prevedono di investire 52 miliardi di dollari, costituiti esclusivamente da risorse pubbliche, mentre la Cina ha programmato contributi pari 150 miliardi di dollari fino al 2025, con l'obiettivo di arrivare a produrre internamente il 70% del proprio fabbisogno di *chip*. È evidente, dunque, il rischio di una "corsa agli investimenti" che potrebbe vanificare gli sforzi europei di attrarre le principali aziende produttrici di *chip* e condurre a un ancora maggiore squilibrio della filiera globale dei semiconduttori.

In questo contesto si comprende l'invito della Commissione ad una maggiore collaborazione con i Paesi definiti come "allineati" (*like-minded countries*) nel rafforzamento della filiera dei semiconduttori. Il tema è stato oggetto di specifici colloqui con gli Stati Uniti durante lo EU-US Trade and Technology

Council del 22 settembre 2021, durante il quale si è sottolineata l'esigenza di evitare una guerra a colpi di sussidi tra le due sponde dell'Atlantico, anche nell'ottica di tutelarsi rispetto al crescente controllo cinese sulla fornitura delle c.d. terre rare, essenziali nella produzione dei semiconduttori. Sempre in questa prospettiva si coglie la *ratio* dell'apertura ad una maggiore collaborazione con Taiwan, *leader* assoluto nel settore.

L'invito alla cooperazione internazionale formulato poco più di un mese fa dalla Commissione risuona quanto mai cruciale successivamente allo scoppio del conflitto in Ucraina. Le difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime per la produzione di semiconduttori saranno probabilmente destinate ad aumentare, se si considera che Ucraina e Russia sono i principali esportatori, rispettivamente, di neon e di palladio, utilizzati l'uno per il taglio laser delle microcomponenti e l'altro per la loro costruzione. In queste circostanze, dunque, l'insieme dei Paesi "occidentali" si trova costretto, ancor più di prima, ad agire d'intesa per evitare di rimanere in scacco della forte posizione della Cina sul mercato delle materie prime per i semiconduttori.

Il successo del piano UE non dipende, tra l'altro, solo dall'entità dei finanziamenti pubblici, ma anche dalla futura domanda di *chip* dell'industria europea. Il settore dell'*automotive*, ad oggi, richiede infatti componenti non particolarmente sofisticate rispetto a quelle usate, ad esempio, nella produzione degli *smartphone* e della computeristica avanzata. Un'evoluzione sotto questo profilo potrebbe giungere dalla diffusione della mobilità elettrica e della guida autonoma; nel frattempo, tuttavia, le aziende più all'avanguardia potrebbero non essere intenzionate ad aprire nuovi stabilimenti in Europa⁴.

⁴ Al contrario, l'americana Intel ha dichiarato di voler aumentare la sua capacità produttiva in Europa. Il Vecchio Continente si presenta infatti come un terreno adatto per il tentativo del colosso californiano di recuperare posizioni rispetto ai *competitor* asiatici nell'ambito della produzione *on demand* di *chip* per terzi. Dopo aver stanziato 20 miliardi per una nuova *giga-factory* in Ohio, negli Stati Uniti, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha annunciato di voler investire fino a 80 miliardi di euro in Europa nei prossimi dieci anni, con l'obiettivo di intercettare la domanda proveniente in primo luogo dall'industria automobilistica. Il piano dell'azienda americana prevede, oltre all'espansione dello stabilimento già esistente nella regione di Kildare, in Irlanda, la costruzione di almeno tre nuovi impianti: una *giga-factory* dedicata alla produzione di *chip*, un sito per il *packaging* (lo stadio finale di incapsulamento dei *chip*) e un centro per il design.

Dopo mesi di intense negoziazioni, Intel dovrebbe annunciare nelle prossime settimane il luogo che ospiterà la *giga-factory*. Diverse fonti riportano che la scelta ricadrà sulla Germania. Tra i fattori che avrebbero determinato questa decisione vi sarebbero l'ingente finanziamento pubblico offerto dal governo tedesco e la disponibilità di

3. Le recenti iniziative dell'Italia: le premesse per un rilancio industriale nel settore dei chip?

Anche l'Italia ha tentato di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel rilancio del settore dei semiconduttori in Europa, stanziando importanti risorse e avviando colloqui con le maggiori società del settore.

Come anticipato, l'Italia ha preso parte all'IPCEI, ottenendo il via libera dalla Commissione per quasi 700 milioni di euro di finanziamenti. In aggiunta, il Decreto Legge del 1 marzo 2022, n. 17, c.d. **"Decreto Caro-Bollette"**, prevede lo stanziamento di un fondo di quasi 4 miliardi di euro fino al 2030 per la promozione della ricerca sui microprocessori e le nuove applicazioni industriali, *"anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale"*. Successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Caro-Bollette) definiranno gli ambiti di applicazione e di intervento del fondo e le modalità di riparto delle risorse. Il finanziamento dovrà comunque essere sottoposto al vaglio della Commissione europea, la quale applicherà, come indicato nella predetta Comunicazione, le regole sugli aiuti di Stato illustrate nel *Chips Act*⁵.

È evidente la volontà del Governo di fare dell'Italia un importante nodo nella produzione europea dei semiconduttori, cogliendo l'opportunità offerta dalla recente iniziativa della Commissione. Del resto, la creazione e lo sviluppo di impianti di produzione di *chip* hanno consistenti ricadute positive non solo in termini di occupazione – stimate nell'ordine di migliaia di assunzioni per ogni impianto, sia di mano-

forza lavoro qualificata, nonché la vicinanza con gli stabilimenti delle maggiori case automobilistiche. In ogni caso, in attesa dello scioglimento definitivo della riserva da parte dell'azienda americana, rimangono vive le speranze di Francia e Italia, anch'esse da diversi mesi al tavolo dei negoziati. Se anche non dovessero essere scelte per ospitare la *giga-factory*, rimarrebbero infatti in lizza per la costruzione dei due impianti di design e *packaging*.

⁵L'ultima iniziativa posta in essere dal Governo italiano è volta certamente ad accelerare i colloqui avviati da mesi con Intel per l'apertura di un nuovo impianto, per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe proposto lo stabilimento di Mirafiori a Torino. Al contempo, le risorse del Governo dovrebbero consentire un'espansione degli impianti produttivi di altre importanti società del settore già presenti sul territorio italiano. Si pensi, ad esempio, all'italo-francese STMicroelectronics, che ha avviato negli ultimi anni un consistente investimento negli impianti di Catania e di Agrate, in quest'ultimo caso in collaborazione con Tower Semiconductor, importante società israeliana di produzione di *chip* recentemente acquisita da Intel. Ancora, il colosso taiwanese GlobalWafers punta a espandere il proprio impianto di Novara con un investimento di circa 300 milioni di euro, attivando una linea di produzione di wafer da 300 mm, oltre a quella già avviata a Merano.

dopera qualificata sia a livello di assemblaggio –, ma anche per l'ecosistema industriale italiano nel suo complesso, che sarebbe maggiormente al riparo dalle crisi della filiera globale e potrebbe beneficiare di componenti tecnologicamente avanzate e di una maggiore sinergia con il mondo della ricerca e dell'università.

DB non solo
diritto
bancario

A NEW DIGITAL EXPERIENCE

 **dirittobancario.it**

